

证券代码：688216

证券简称：气派科技

气派科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	光大证券 赵丹晨 中金资本 刘弦 广州海融鑫投资 邵立 中财招商投资集团 刘倩妤 聚众鑫创 彭建彬 聚众鑫创 崔学谦
时间	2026年1月29日 15:00-16:00
地点	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
上市公司接待人 员姓名	董事会秘书 文正国
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司介绍基本情况</p> <p>略</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、请问最近行业情况如何？</p> <p>答：受2020~2021年半导体行业爆发式增长的影响，大量</p>

	<p>资本涌入，产能的无序扩张及行业去库存导致封测价格呈现大幅度下降；经过持续三年多的去库存期，终端需求逐渐恢复增长，目前整体行业回暖，从 2025 年四季度开始订单逐步饱满。另外随着 AI、算力、存储等需求对先进封装产能要求较高，挤占了封测行业龙头的传统封装产能，行业整体情况向好。从订单方面来看，公司目前来料订单创新高。</p> <p>2、2021 年的行业需求旺盛导致大量资本进入封装测试行业，从而导致产能过剩。而近年来 AI 行业的蓬勃发展是否同样会资本冲击导致产能过剩，请问公司预计如何面对？</p> <p>答：随着半导体行业的周期结构调整，就传统封装方面而言，封装企业结构目前较为稳定、封装技术较为成熟，国内的封装企业基本能够覆盖行业上游客户。目前这次的 AI 发展需求有别于 2021 年的对传统封装需求，而是对先进封装有较大的需求。公司将结合本轮行业发展起因以及终端需求进行分析，对应积极调整公司产品、产能等，以最高效方式实现规模提升。</p> <p>3、请问公司目前订单是哪些产品为主？</p> <p>答：主要是大消费类为主，具体比如手机、家电、蓝牙、电源管理等，其他包括存储、储能、工控、5G 通讯等等。</p> <p>4、请问目前消费电子的情况如何？</p> <p>答：从各个协会数据统计，消费电子的需求量还在不断增加，国内外的封装测试产量都在持续增加，整体情况向好。</p>
--	--

	<p>6、请问公司未来发展规划？</p> <p>答：2026年公司全力以赴提高公司规模，一方面随着行业景气度回暖，以及目前原材料、设备等上下游的涨价趋势，公司将结合实际情况逐步推动不同产品的价格调整；另一方面公司将根据本次行业周期的恢复调整公司产品结构、产能分配。</p> <p>7、请问公司目前在手订单可以覆盖多少产能？</p> <p>答：公司统计的在手订单主要是客户晶圆已在公司并下单的订单，另外还有客户的晶圆已放置在公司进行保管，之后根据客户需求再转化为订单。</p> <p>8、请问公司2026年可以扭亏吗？</p> <p>答：随着行业整体转暖，公司将全力以赴，2026年是否扭亏还需要根据行业景气度能否持续以及公司产品价格调整进度等因素结合推进。</p>
	无
日期	2026年1月29日